公司代码：688691　　公司简称：灿芯股份

灿芯半导体（上海）股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，结合相关法律法规，综合考虑公司目前经营计划和实际经营需求等因素，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	灿芯股份	688691	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈文萍	石啸天、梁砚卿
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区张东路1158号礼德国际2号楼7楼	中国（上海）自由贸易试验区张东路1158号礼德国际2号楼7楼
电话	021-50376585	021-50376585
传真	021-50376620	021-50376620
电子信箱	IR@britesemi.com	IR@britesemi.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主要业务情况

公司是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。公司定位于新一代信息技术领域，自成立至今一直致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务，并以此研发形成了以大型SoC定制设计技术与半导体IP开发技术为核心的全方位技术服务体系。

依托完善的技术体系与全面的设计服务能力，公司不断帮助客户高质量、高效率、低成本、低风险地完成芯片设计开发与量产上市。公司为客户提供芯片设计服务最终转化为客户品牌的芯片产品被广泛应用于物联网、工业控制、消费电子、网络通信、汽车电子、智慧城市等行业。公司凭借技术和服务的优异表现，获得了“中国半导体创新产品和技术奖”、“中国半导体市场最佳设计企业奖”、“上海市浦东新区科学技术奖”、“2025中国IC设计成就奖之年度优秀IC设计服务公司”、“2025中国IC设计Fabless100排行榜TOP 10 IP公司”等多项荣誉奖项。

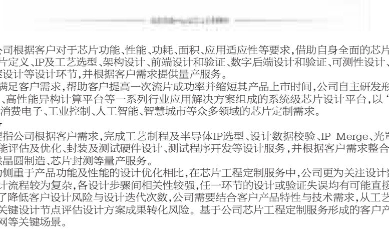
公司拥有基于中国大陆自主先进工艺进行芯片定制的能力，并在先进工艺实现自研高速接口IP及高性能模拟IP布局，是境内少数具有先进工艺全流程设计能力并有成功芯片定制经验的企业。除先进逻辑工艺设计能力外，公司还具备覆盖高压工艺、非挥发性存储器工艺、微电子和光电子集成工艺等先进特色工艺设计能力。

2、公司主要服务情况

公司基于自身全面的芯片设计能力、深厚的半导体IP储备与丰富的项目服务经验，为客户提供一站式芯片定制服务，包括芯片定义、IP选型及授权、架构设计、逻辑设计、物理设计、设计数据校验、流片方案设计等全流程芯片设计服务。公司在为客户提供芯片设计服务后，根据客户需求可继续为其提供芯片量产服务。

公司在长期为客户提供一站式芯片定制服务的过程中，了解并捕捉到了不同行业应用领域对于半导体IP的差异化需求，并因此逐渐开发形成了一系列高性能半导体IP（You IP），提升了公司一站式芯片定制服务的综合竞争力。

由于集成电路产业中不同行业领域客户技术禀赋、产品需求各不相同，公司基于自身核心技术可在芯片设计全流程为客户提供技术支持，并根据客户需求提供相应设计服务。从服务类型来看，公司为客户提供的一站式芯片定制服务主要可分为芯片全定制服务与芯片工程定制服务。



（1）芯片全定制服务

芯片全定制服务是指公司根据客户对于芯片功能、性能、功耗、面积、应用适应性等要求，借助自身全面的芯片定制能力及丰富的设计经验，根据客户需求完成芯片定义、IP及工艺选型、架构设计、前端设计和验证、数字后端设计和验证、可测性设计、模拟电路设计和版图设计、设计数据校验、流片方案设计等设计环节，并根据客户需求提供量产服务。

同时，为了更好更快地满足客户需求，帮助客户提高一次流片成功率并缩短其产品上市时间，公司自主研发形成了由高清音视频DSP平台、物联网微控制器平台、高性能异构计算平台等一系列行业应用解决方案组成的系统级芯片设计平台，以“标准化方案+差异化设计”的模式快速满足客户在消费电子、工业控制、人工智能、智慧城市等众多领域的芯片定制需求。

（2）芯片工程定制服务

芯片工程定制服务主要指公司根据客户需求，完成工艺制程及半导体IP选型、设计数据校验、IP Merge、光罩数据验证、流片方案设计及工艺裕量优化、系统性能评估及优化、封装及测试硬件设计、测试程序开发等设计服务，并根据客户需求整合晶圆代工厂与封测厂等第三方厂商资源向客户提供晶圆制造、芯片封测等量产服务。

与芯片全定制服务更为侧重于产品功能及性能的设计优化相比，在芯片工程定制服务中，公司更为关注设计数据与物理结构、工艺特性的一致性。而由于芯片设计流程较为复杂，各设计步骤间相关性较强，任一环节的设计或验证失误均有可能直接导致设计数据无法正常交付或流片失败。因此，为了降低客户设计风险与设计迭代次数，公司需要结合客户产品特性与技术需求，从工艺制程及IP选型阶段即提供技术支持，并帮助客户在关键设计节点评估设计方案成果转化风险。基于公司芯片工程定制服务形成的客户产品已被广泛应用于物联网、高性能计算与工业互联网等关键场景。

2.2主要经营模式

1、公司商业模式概述

公司所处集成电路行业产业链主要由集成电路设计、晶圆制造和封装测试等环节组成，集成电路企业按照是否自建晶圆生产线及封装测试生产线主要分为两种经营模式：IDM模式和Fabless模式。IDM模式下，企业集芯片设计、制造、封装和测试等多个产业链环节于一体，可自主完成芯片设计到量产交付的全部工作，代表公司主要包括三星电子、英特尔等。Fabless模式，即无晶圆厂制造模式，采用该种经营模式的企业专注于集成电路的设计、研发和销售，将晶圆制造、封装测试等生产环节委托给专业的晶圆代工厂商和芯片封装测试厂商完成，代表公司包括高通、博通等。

公司作为采用Fabless模式的芯片设计服务企业，为客户提供从芯片定义到量产的一站式芯片定制服务。公司技术能力覆盖芯片开发的全流程，客户可以根据自身需求灵活选择芯片开发过程中全部或部分阶段的服务内容。

在经营模式方面，公司与同样采用Fabless模式的芯片设计公司亦存在一定差异。公司作为芯片设计服务公司，并不通过销售自有品牌芯片实现收入，而是依托自身IP及SoC定制开发能力为芯片设计公司及系统厂商等客户提供一站式芯片定制服务开展业务，市场风险和库存风险较小。公司依托自身核心技术为客户提供一站式芯片定制服务，最终转化为客户品牌的芯片产品。

上述经营模式具有平台化、可规模化的特点，该种经营模式使得公司集中资源于可复用性高、具备应用领域扩展性的技术平台，通过持续输出技术能力帮助客户高效完成芯片定制开发及量产，形成了较高的竞争壁垒。

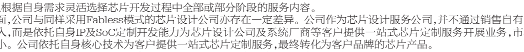
2、盈利模式

公司作为典型的集成电路设计服务企业， 主要通过向客户提供芯片设计服务并依据其产品需求提供芯片量产服务以实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入均来源于公司一站式芯片定制服务。

3、研发模式

公司一站式芯片定制服务研发方向包括应用于公司系统级芯片设计平台与高性能半导体IP的研发。

（1）系统级芯片设计方案的研发流程



公司系统级芯片设计方案主要根据公司对市场需求的分析，针对行业应用领域的功能、性能、面积等需求，结合自有或第三方IP自主开发相应的可复用系统级芯片设计方案并应用于客户的项目实现中，主要内容如下：

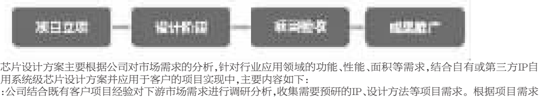
①项目立项：公司结合既有客户项目经验对下游市场需求进行调研分析，收集需要预研的IP、设计方法等项目需求。根据项目需求设定研发目标、时间表及开发计划，并编制工作说明书与预算表；

②设计阶段：研发项目经立项后，根据工作说明书执行项目研发，按研发目标和时间表对项目进行阶段性成果审核，并根据项目进展调整研发资源的投入以保障项目顺利开展；

③项目验收：根据既定的研发目标，由公司技术负责人组织评审团队审议项目研发成果，检查电路逻辑的正确性以及设计约束、功能逻辑、物理实现的一致性；

④成果推广：根据验收结果，会由公司销售团队向客户进行成果推广，并由研发及技术人员在实际项目应用中对产品技术规格或数据手册进行修正，以不断提高系统方案的性能与可复用性。

（2）半导体IP的研发流程



①市场需求分析：市场部门针对外部市场发展趋势、讨论和评估新的市场机会以及新产品可能带来的潜在市场回报，用于指导新产品的研发，并形成市场需求文档；

②产品规格制定：制定符合市场需求及具有市场竞争力的产品规格及性能指标，并输出产品需求文档及设计规格说明书；

③编制研发计划：根据产品规格及性能指标，制定产品研发周期及具体执行计划；

④IP架构设计验证和物理实现：设计和优化能够满足设计规格书的IP架构，输出IP架构设计方案，利用多种EDA工具进行IP设计及验证，并对IP测试芯片进行物理设计；

⑤IP性能测试与流片验证：针对实测性能及应用场景需求，根据相关国际行业标准进行兼容性测试，并通过设计数据校验、流片方案设计等环节后，完成IP硅验证；

⑥IP设计验收：输出通过设计验证和性能测试的RTL代码、IP设计数据及相应的设计报告。

4、采购与生产模式

在Fabless模式中，公司不直接从事晶圆制造、封装测试或其他生产加工工作，相关生产环节均由第三方外协厂商完成。公司的采购主要由生产运营部门负责，并在销售部门的配合下完成。其中，生产运营部门主要负责订单管理与质量管控，协调晶圆厂商、封测厂商持续改善良率，并不断推动供应商认证和质量改进等工作。

公司的采购模式主要包括一般采购模式和客户订单需求采购模式。一般采购模式主要适用于公司研发所需的通用软硬件采购，主要采购内容包含EDA工具、IP、服务器、测试设备等，该类采购不针对特定客户项目。客户订单需求采购模式主要适用于公司一站式芯片定制服务，公司根据客户订单需求，以委外的形式向第三方厂商采购晶圆、封测服务及IP等。公司在委外环节中严格执行产品质量管控并参与工艺优化、芯片测试方案设计等工作。

公司已建立完善的供应商开发与管理制度，公司生产运营部门从工艺能力、生产能力、质量体系、供应链安全和商务条件等方面对供应商进行综合评估。满足公司上述评估条件的供应商将进入公司合格供应商列表，方可开始向其进行批量采购。公司已与行业内知名晶圆代工厂、封装测试厂建立了良好的合作关系，包括中芯国际、华润上华等知名晶圆代工厂商及华天科技、日月新等知名封装测试厂商。

5、销售及营销模式

公司为客户提供的一站式芯片定制服务具有典型的定制化特点，需要根据客户的差异化芯片定制需求，提供有针对性的芯片设计服务及由设计服务导入的芯片量产服务。因此，报告期内公司采用直销模式。

在市场营销方面，公司通过在目标客户集中区域设置销售中心，能够及时了解下游市场动态并挖掘客户需求。公司在捕捉到潜在客户需求后即在内部联合技术团队进行售前项目评估，并在制定项目方案后与客户进行商务谈判。在双方达成意向后，公司与客户确定合作细节并签订销售合同。通过与客户的直接对接，公司可以更高效地就其需求进行沟通并快速做出反应，从而更敏锐地捕捉市场信息并作出及时调整，确保自身的竞争优势。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

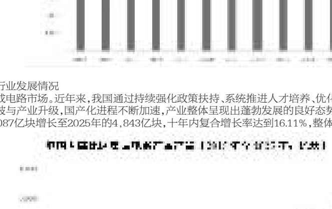
1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业，属于集成电路设计产业，处于新一代信息技术领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“软件和信息技术服务业”下的“集成电路设计”（行业代码：I6520）。

（1）行业发展阶段及基本特点

①全球集成电路市场行业发展情况

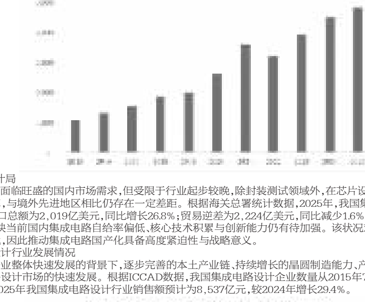
集成电路自出现以来，历经六十余年的发展，目前被广泛应用于消费电子、通信、汽车以及工业等领域。近年来，伴随着人工智能、物联网、虚拟现实等新技术的不断涌现与发展，全球集成电路市场规模总体呈现在波动中逐步增长的态势。根据全球半导体贸易统计组织（WSTS）数据，全球集成电路市场规模在2015年-2025年期间由3,352亿美元增加至7,956亿美元，复合增长率约为9.03%。近年来，随着5G通信、汽车电子、移动智能终端、人工智能等下游应用市场的需求快速增长，集成电路行业市场规模保持持续增长态势。根据WSTS预计，2026年全球半导体市场规模将达到9,755亿美元，同比增长超过25%。



数据来源：WSTS

②中国集成电路市场行业发展情况

中国是全球重要的集成电路市场。近年来，我国通过持续强化政策扶持、系统推进人才培养、优化产业生态等一系列举措，全力推动本土集成电路行业的技术突破与产业升级，国产化进程不断加速，产业整体呈现出蓬勃发展的良好态势。根据国家统计局数据，我国集成电路产品产量从2015年的1,087亿块增长至2025年的4,843亿块，十年内复合增长率达到16.11%，整体而言保持了快速增长态势。

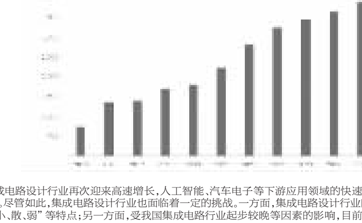


数据来源：国家统计局

我国集成电路产业面临旺盛的国内市场需求，但受限于行业起步较晚，除封装测试领域外，在芯片设计、制造等关键环节的整体技术水平和国际市场占有率，与境外先进地区相比仍存在一定差距。根据海关总署统计数据，2025年，我国集成电路进口总额为4,243亿美元，同比增长10.1%；出口总额为2,019亿美元，同比增长26.8%；贸易逆差为2,224亿美元，同比减少1.6%。大规模进口依赖既表明国产替代存在广阔空间，也反映当前国内集成电路自给率偏低、核心技术积累与创新能力仍有待加强。该状况对我国产业转型升级乃至产业链安全可控构成潜在挑战，因此推动集成电路国产化具备高度紧迫性与战略意义。

③中国集成电路设计行业发展情况

在我国集成电路产业整体快速发展的背景下，逐步完善的本土产业链、持续增长的晶圆制造能力、产业政策及资金方面的支持等因素共同推动国内集成电路设计市场的快速发展。根据ICCAD数据，我国集成电路设计企业数量从2015年736家增加至2025年3,901家。同时，根据ICCAD数据，2025年我国集成电路设计行业销售额预计为8,537亿元，较2024年增长29.4%。



数据来源：ICCAD

2025年度，我国集成电路设计行业再次迎来高速增长，人工智能、汽车电子等下游应用领域的快速发展将在未来进一步带动我国集成电路设计行业的发展。尽管如此，集成电路设计行业也面临着一定的挑战。一方面，集成电路设计行业的产业集中度仍然较低，市场参与者存在一定程度上的“小、散、弱”等特点；另一方面，受我国集成电路行业起步较晚等因素的影响，目前我国集成电路设计行业在中高端芯片领域的竞争力仍然有待提升，在人工智能、汽车电子等新兴领域的技术能力和产品能力仍需进一步积累。此外，伴随近年来国内集成电路行业的快速发展，人力成本的上涨也导致集成电路设计企业的运行成本不断增长，日益复杂的国际地缘政治形势也对我国集成电路设计企业的发展提出了新的挑战。

④集成电路设计服务行业发展情况

在集成电路行业发展初期，其作为一项新兴技术，研发、制造等被少数大型企业掌握，芯片企业通常采用IDM模式。随着集成电路产业的不断发展，集成电路产业中的设计、制造、封装测试等环节逐步分离，产业链分工日益精细。与此同时，随着集成电路终端应用的多样性与复杂性的快速增加，芯片设计难度亦随之提升，因此集成电路设计行业的分工进一步细化为芯片设计公司、芯片设计服务公司、半导体IP供应商与EDA工具供应商等。

芯片设计服务公司的客户群体主要包括系统厂商与芯片设计公司。对于系统厂商而言，其对终端场景需求、产品功能有着较为深刻的理解，由于其在芯片设计、验证、测试等方面欠缺相关技术能力与设计经验，往往无法独立开发芯片，因此其可以借助芯片设计服务公司为其提供一站式芯片定制服务，从而实现产品快速开发与迭代。对于芯片设计公司而言，一方面芯片设计服务公司能够为其在设计之初提供生产工艺及半导体IP选型的完整方案，另一方面芯片设计服务公司基于自身核心技术及对晶圆代工厂多工艺节点的丰富设计经验，能够帮助芯片设计公司提高设计效率及流片成功率。因此，集成电路行业的发展推动了集成电路设计服务行业的重要性的提升。

近年来， 随着消费电子、 网络通信、 工业控制等终端市场的发展， 集成电路设计服务行业的市场空间也随之增长。根据Global Growth Insights统计，2025年全球集成电路设计服务行业的市场规模为528.8亿美元，预计2026年将增长至548.6亿美元，并在2035年达到763.4美元。其中亚太地区占全球需求的近44%。

（2）主要技术门槛

集成电路设计行业是典型的技术密集型行业，需要具备深厚的技术和经验积累，并通过持续的研发创新以及前瞻性的市场布局才能从技术层面不断满足市场需求。行业内的后入者往往需要通过较长时间的技术摸索和积累才能与业内已建立较强技术优势的企业开展竞争，因此公司所处行业具有较高的技术门槛。

具体而言，公司所处的集成电路设计服务行业具有定制芯片种类众多、设计失败风险高、设计效率要求高等特点，需要具备面向多应用领域、多工艺平台的完整芯片设计能力，技术难度较高。在消费电子领域，由于消费电子产品随着新兴应用场景需求的不断涌现在种类上不断增多，对芯片产品的迭代速度、开发上市周期及成本控制要求较高，且对体积和功耗要求较为严格，因此对芯片设计服务企业在芯片设计效率、流片成功率、低功耗设计能力等方面的要求较高；在工业控制领域，该领域对芯片可靠性、实时性等方面的技术要求及设计难度更高，对芯片设计服务企业在设计可靠性和产品差异化性能方面的要求较高；在物联网领域，由于功耗及信号转换精度是物联网芯片的关键性能指标，因此其对芯片设计服务企业在模拟电路设计以及物理设计能力方面提出了较高的要求。此外，在网络通信、汽车电子、智慧城市等领域，基于各领域的应用特点，亦分别对芯片设计服务企业在工艺制程、高速接口IP、极大规模集成电路设计、可靠性、定制化功能及性能实现等不同方面提出了相应的要求。

同时，为满足公司一站式芯片定制服务开展过程中部分关键IP的需求，公司针对高速接口IP与高性能模拟IP进行了自主研发，形成了一系列IP储备并应用于主营业务中。上述IP研发也具有较高的技术门槛。高速接口IP的技术门槛包括数据传输速率、带宽、稳定性、兼容性等方面，高性能模拟IP的技术门槛包括转换精度、转换速率、功耗及面积等方面，整体而言对相关企业在模拟电路设计能力、低功耗设计能力、关键性能指标优化能力等方面提出了较高的要求。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是全球集成电路设计服务行业的头部厂商，同时基于对自身发展战略、客户需求、行业发展趋势等因素的综合考虑，选择与中国大陆技术最先进、规模最大的晶圆代工厂中芯国际建立了战略合作伙伴关系。多年来，公司积极参与全球竞争，吸引并服务了众多境内外知名客户，在全球集成电路设计服务产业竞争中占据了重要位置。

公司一直致力于为客户提供优质可靠的一站式芯片定制服务，不断深耕对不同工艺制程的研究，通过将芯片设计方法学与物理结构相结合进行芯片设计，帮助客户高效率、低风险地完成芯片设计与量产交付。基于全面的技术服务体系与成熟的系统级芯片设计平台，公司得以不断吸引面向不同场景的众多芯片设计公司、系统厂商等客户。公司紧跟大陆自主先进工艺进行全流程设计，具备自主先进逻辑工艺与先进特色工艺全流程设计能力，实现了多工艺节点、多工艺平台的覆盖。公司聚焦系统级（SoC）芯片一站式定制服务，定制芯片包括系统主控芯片、光通信芯片、5G基带芯片、卫星通信芯片、网络交换机芯片、FPGA芯片、无线射频芯片等关键芯片，上述产品被广泛应用于物联网、工业控制、网络通信、高性能计算等众多高技术产业领域中，满足了不同场景差异化、个性化需求，建立了较强的竞争壁垒。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）所属行业在新技术方面近年来的发展情况与未来发展趋势

①逻辑工艺与特色工艺推陈出新，集成电路器件线宽不断缩小

随着摩尔定律的不断演进，制造工艺及器件微观结构对芯片的速度、可靠性、功耗、面积等关键指标的影响越来越大。近年来，下游新兴应用的不断涌现及用户对于产品性能要求的不断提高，均对逻辑电路及其他集成电路和半导体器件类型都提出了更高的要求。在逻辑工艺方面，已由本世纪初的0.35微米的CMOS工艺发展至纳米级FinFET工艺并应用于高性能计算、安全加密、消费电子等领域。在特色工艺方面，随着更多的应用需求转为通过半导体技术实现，出现了如BCD、EFlash、LCOS、SOI等特色工艺平台，并被应用于电源管理、高速非易失性存储、显示器件等领域。

随着集成电路工艺制程的不断演进与特色工艺的不断创新，集成电路设计服务企业在不同工艺、不同制程上的工艺分析能力、全流程设计能力及项目流片经验将成为其重要竞争优势。

②下游需求的多样性催生了SoC芯片技术的发展

随着下游应用场景的增多及对芯片产品差异化需求的涌现，集成电路设计产业被要求在不断提升产品性价比、缩短上市周期的同时快速满足差异化需求，SoC芯片技术应运而生。

SoC芯片技术是从设计的角度出发，将系统所需的组件进行高度集成，将原本不同功能的集成电路以功能模块的形式整合在一颗芯片中，以缩小芯片面积、提升芯片的运算速度并加快开发周期。相比传统芯片产品对每个关键模块从头设计进而进行系统整合及验证的开发方式，SoC芯片设计及验证技术旨在提高模块复用性，通过重复使用预先设计并验证过的集成电路子模块以降低设计风险、降低设计成本并提高设计质量。同时，大型SoC的设计开发对于产品架构设计技术、半导体IP库标准化及完整性、大规模物理设计及验证技术提出了极高的要求，部分行业领先企业已有相关技术布局。

③人工智能、物联网、高性能计算等新兴技术的快速发展推动先进封装、Chiplet等新技术革新

集成电路行业主要沿着两个技术路线发展，一是延续摩尔定律，即发展制程工艺，通过持续微缩晶体管栅极尺寸，从而在单位面积容纳更多晶体管；二是超越摩尔定律，即通过多样化发展先进封装技术，实现小型化、轻薄化、高密度、低功耗和功能融合等优点。随着晶体管尺寸接近物理极限，摩尔定律的推进速度减缓，单纯依靠制程微缩提升芯片性能的难度加大，同时集成电路的发展还面临存储器、芯片面积、功耗、功能等多方面的限制，因此随着人工智能、物联网、高性能计算等新兴技术的发展，超越摩尔定律这条发展路线的重要性愈发凸显。

先进封装也被称为高密度封装，通过缩短I/O间距和互联长度，提高I/O密度，进而实现芯片性能的提升。相比传统封装，先进封装拥有具有更高集成度、更高性能、更低功耗和更小尺寸的特点，并且支持异构集成，能够将不同工艺节点、不同功能的芯片整合在一起，目前主流的先进封装技术包括WLP、2.5D封装、3D封装等。先进封装技术能够在晶体管尺寸不变的情况下提升芯片性能，是未来集成电路行业发展的重要突破口之一。根据研究机构Yole的预测，全球先进封装市场规模有望从2023年的468亿美元增长至2028年的786亿美元。

Chiplet（芯粒）技术是一种半导体设计方法，它将一些预先生产的实现特定功能的芯片裸片通过先进封装技术集成在一起，形成一个完整的芯片。Chiplet技术旨在提高芯片设计的灵活性、降低成本、提升性能。近年来，由于人工智能等新应用导致芯片体积增加从而带来大面积单颗SoC良率下降，Chiplet技术通过将单颗SoC的不同功能模块进行拆分，并且不同的模块可以选取最合适的制程，能够较大程度上提升最终芯片的良率以及芯片整体设计的灵活性，而先进封装技术的发展也为Chiplet技术的实现提供了基础，在先进工艺技术发展受阻时，Chiplet技术为前沿芯片技术的发展提供了新的路径。公司目前是通用Chiplet高速互联标准UCIe联盟的成员企业之一。

④自主可控、边缘计算等需求带动RISC-V的发展

RISC-V是一个基于精简指令集（RISC）原则设计的开源指令集架构，相较于ARM/x86架构，RISC-V具有高灵活性、低成本、低功耗的特点，目前最领先的基于RISC-V的IP内核已接近ARM Cortex-A78的性能水平。目前，RISC-V主要应用于IoT、边缘计算、消费电子等领域。一方面，随着人工智能领域的迅速进展，边缘AI设备有望迎来快速发展，而RISC-V在功耗和能效比方面的优势有望成为边缘AI设备的理想选择，通过集成多个RISC-V内核与专用AI加速器，可以形成异构计算平台，实现任务的高效协同处理，并在手机边缘侧、AI眼镜等领域得到应用。另一方面，在ARM/x86架构存在不授权或不供应等风险的大背景下，RISC-V架构由于具备开源开放的特殊属性，被认为是国产芯片弯道超车的机遇，亦有望成为第三大架构生态。

（2）所属行业在新产业方面近年来的发展情况与未来发展趋势

经过多年的发展，集成电路产业一方面在技术上实现不断突破，另一方面也在应用领域方面不断突破迭代，带动了众多新产业的进步。近年来，人工智能、物联网、边缘计算、汽车电子、医疗电子等新兴领域蓬勃发展，为集成电路产业发展带来了新的机遇。

①人工智能

人工智能是一门融合计算机科学、数学、统计学、神经科学等多学科知识的综合性技术领域，旨在通过构建智能系统，运用神经网络、深度学习、机器学习等算法从大量数据中提取特征、模式和规律，使其具备模拟、延伸和扩展人类及自然智能的能力，如学习、推理、思考、规划等，继而让计算机实现更高层面的智能应用。2022年11月，OpenAI发布了ChatGPT，催生了全球对大型模型技术的高度关注和加速发展。

从实现路径来看，算法、算力及数据是实现人工智能的三驾马车，其中算力是构筑人工智能时代的物理基石和底层基础设施，是开启人工智能时代的关键要素之一。随着大模型快速迭代，模型参数和训练数据量的持续增长与人工智能算法的不断更新增强，需要更强大的算力来支撑人工智能训练和推理过程，不断促进算力需求同步增长。

具体而言，人工智能技术在实际应用中包括训练和推理两个环节，训练环节是指通过数据开发出人工智能模型，使其能够满足相应需求；推理环节是指利用训练好的模型进行计算，利用输入的数据获取正确结论的过程，不同的环节所需芯片的特点及类型亦有所不同。在训练侧，由于人工智能模型在训练过程需要处理大量的数据和复杂的计算，对芯片的计算能力、内存带宽和并行处理能力要求非常高，同时在训练过程中需要不断地调整模型的参数和结构，因此目前普遍使用GPU执行训练任务。在推理侧，因为人工智能模型已经训练完毕，此时对芯片的计算精度要求相对较低，但对计算速度、能效和成本要求较高，而ASIC（专用集成电路）因其高度定制化的设计能够针对推理任务进行优化，并以较低的功耗实现快速的推理计算，在推理侧具有较为明显的优势。此外，尽管当前训练侧使用GPU较多，但研发定制化的人工智能芯片在成本、供应安全、自主可控、能效比等方面均具有较为明显的优势，未来在训练侧也有广阔的市场空间。

此外，在人工智能大模型突飞猛进的同时，由于其通常部署于云端服务器，因此在网络延迟、数据安全等方面也面临一定的挑战，鉴于终端侧AI在可靠性及时延、隐私及安全性、成本及能耗等方面的优势，业界预期今后在边缘终端部署AI模型将是人工智能领域重要的发展方向，从而也将驱动定制化的低功耗边缘AI芯片、集成端侧AI模型的SoC芯片等硬件产品的发展。

②物联网

物联网是万物互联的核心技术，其基础是通过标准通讯协议使得各种物体可以互相通讯和连接，并根据应用场景将数据传输到云端进行处理和控制，无线连接是物联网的主要实现方式。针对不同场景的物联网连接需求，无线连接技术包括WiFi、蓝牙等局域无线通信技术，以及5G、NB-IoT等广域无线通信技术。物联网下游应用分布广泛，覆盖了工业制造、交通运输、智慧能源、智慧零售、智慧城市等。

近年来，随着新技术及新应用场景的涌现，物联网领域保持持续快速发展态势。一方面，无线连接技术的进步推动了物联网设备数量的迅速增长。在Wi-Fi领域，Wi-Fi 6的推出解决了传统Wi-Fi设备信号传输覆盖范围小、功率消耗大等弊端，能够低成本满足室内办公、零售及娱乐等场景的连接需求。同时，最新一代的Wi-Fi 7标准在Wi-Fi 6的基础上能够提供更高的数据传输速率和更低的时延，目前主要应用于高端设备，预计从2026年至2027年将逐渐得到更加普遍化的应用，到2030年成为主要Wi-Fi应用标准之一。在蓝牙领域，低功耗蓝牙技术具备传输距离远、功耗低和延迟低等突出优势，随之诞生的低功耗蓝牙组网技术也使得设备 “多对多” 通讯成为可能，通过Wi-Fi 6的高带宽与低功耗蓝牙的低功耗特性，物联网设备能够具备高速、低功耗的无线连接能力，从而实时、有效地收集并传输数据至云端进行处理。

另一方面，新场景的出现进一步带来了物联网市场的增长空间，随着人工智能应用的发展，新型AI硬件如AI玩具、AI眼镜、AI智能家居等设备需求扩容，而这些新型硬件均需要搭载相应的物联网模组，此外如智能网联汽车等场景的普及也带动了对物联网的需求。

③汽车电子

汽车行业是国民经济的重要部门之一，近年来我国汽车行业发展迅速，尤其是新能源汽车的渗透率逐年增加。在汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”趋势的带动下，车用芯片的数量和种类逐渐增加。根据中国汽车工业协会的数据，传统燃油车所需汽车芯片数量为600-700颗/辆，新能源汽车所需的汽车芯片数量将提升至1,600颗/辆，而更高阶的智能驾驶汽车对芯片的需求量则有望提升至3,000颗/辆。

新能源汽车的发展一方面带动了对汽车芯片数量的需求，另一方面也推动汽车电子电气架构的演进，从而使得域控制器的需求增加。传统功能汽车采用分布式电子电气架构，离散化的ECU（电子控制单元）软硬件紧耦合且各ECU之间独立性较强，难以适应汽车智能化革新的趋势和需求。DCU（域控制器）将功能相似且分离的ECU功能进行整合，一辆整车可以划分为动力域、底盘域、座舱域、自动驾驶域、车身域五个域，每个域的系统架构由域控制器为主导搭建，并利用处理能力和算力更强的芯片相对集中地控制每个域。域控制器通常由域主控处理器、操作系统和应用软件及算法等三部分组成，其中作为主控处理器的芯片需要具备高性能、高集成度、低能耗、高安全性等特点，这使得ASIC方案成为车辆域控处理器的重要发展方向之一。

④医疗电子

医疗电子芯片应用领域广泛，既包括呼吸机、除颤器、胶囊胃镜、植入式起搏器等服务于医疗机构的医用医疗设备，也包括血糖监测仪、电子血压计、血氧仪等应用于日常健康管理的家用医疗设备。对于医用医疗设备而言，多种类型的芯片已在医疗设备中使用多年，随着医疗设备的国产化进程推进以及终端用户对使用成本、性能、成像清晰度等方面要求的提升，基于新工艺、新技术的国产化芯片有望在更多的医用医疗设备中得到使用。对于家用医疗设备而言，随着国民健康意识的增强，以及云端服务、低功耗技术等的发展，家用医疗设备市场规模逐步增加。以动态血糖监测（CGM）领域为例，通过植入一次性葡萄糖传感器连续监测葡萄糖水平，能够记录整个时间段内血糖变化情况，同时还可以配合糖尿病治疗，预计2030年全球市场规模将达到364亿美元。在CGM设备中，重要组成部分便是基于模拟前端芯片及低功耗蓝牙芯片的硬件模组，而随着CGM领域低成本、高性能、小型化趋势的演进，将不同功能集成的SoC方案有望得到应用。

（3）所属行业在新业态、新模式方面近年来的发展情况与未来发展趋势

伴随技术进步、行业竞争和市场需求的不断变化，集成电路产业在经历了多次结构调整后，已逐渐由集成电路设计、制造以及封装测试只能在企业内部一体化完成的垂直整合元件制造模式演变为垂直分工的多个专业细分产业，并逐渐形成由EDA工具及半导体IP、设计服务、材料和设备提供厂商组成的产业链上游，由采用Fabless模式的芯片设计公司、从事晶圆制造、封装测试的厂商组成的产业链中游与由系统厂商组成的产业链下游。

在芯片设计产业方面，随着集成电路工艺种类的丰富与先进工艺的持续演进，芯片工艺及IP选型难度、设计难度及流片风险不断提升，导致产品设计时间及开发成本显著增加。同时随着下游场景需求波动对芯片生命周期的影响，芯片设计效率与一次流片成功率成为企业在激烈的市场竞争中保持竞争优势的关键因素。越来越多的芯片设计公司及系统厂商集中研发力量在自身核心优势上，并选择将前端设计、物理设计、流片、晶圆生产、封装与测试等产品开发过程中的部分或全部环节交由设计服务公司完成，以求实现更短的设计周期、更少的流片迭代次数与更高的产品性能提升。

此外，随着半导体设计行业分工专业化的发展，半导体IP行业也越发成熟。未来，随着工艺节点不断升级并演进，单颗芯片可集成的IP 数量亦将随之不断增多，从而进一步推动半导体 IP 市场的发展。现阶段，我国集成电路设计企业在产品研发过程中大多采用的是国外芯片巨头企业的 IP。一方面，国外企业具有的优势地位使得授权费用较高，增加了我国芯片设计企业的设计成本；另一方面，半导体核心技术和知识产权长期受制于人将对于我国国产芯片的自主和安全产生潜在的风险。因此，推进关键 IP 国产化是市场的选择也是国家战略的需求。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,647,662,093.20	1,735,365,244.83	-5.05	1,353,954,680.61
归属于上市公司股东的净资产	1,238,052,924.92	1,365,364,463.25	-9.32	819,379,192.85
营业收入	724,446,205.33	1,089,661,179.43	-33.52	1,341,492,617.61
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	724,446,205.33	1,089,661,179.43	-33.52	1,341,492,617.61
利润总额	-136,675,001.94	64,538,691.00	-311.77	182,682,029.58
归属于上市公司股东的净利润	-110,320,847.20	61,047,210.89	-280.71	170,471,483.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-120,654,999.22	44,046,103.26	-373.93	146,045,718.10
经营活动产生的现金流量净额	18,587,857.99	9,116,685.72	103.89	36,662,377.40
加权平均净资产收益率（%）	-8.49	5.18	减少13.67个百分点	23.44
基本每股收益（元／股）	-0.9193	0.56	-264.29	1.89
稀释每股收益（元／股）	-0.9193	0.56	-264.29	1.89
研发投入占营业收入的比例（%）	24.73	11.73	增加13.00个百分点	8.07

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	138,818,685.56	142,980,129.45	186,280,116.00	256,367,274.32
归属于上市公司股东的净利润	-25,813,105.48	-35,069,165.14	-33,611,811.96	-15,826,764.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,019,441.81	-42,036,191.59	-36,290,567.67	-14,308,798.15
经营活动产生的现金流量净额	3,984,590.00	-8,613,526.00	-17,088,012.44	40,304,806.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,230
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,269
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中芯国际控股有限公司	0	17,078,490	14.23	17,078,490	无	0	境内非国有法人
NORWEST VENTURE PARTNERS X, LP	0	12,118,590	10.10	12,118,590	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金	5,257,539	5,260,000	4.38	0	无	0	其他
上海维灿企业管理中心（有限合伙）	0	3,848,490	3.21	3,848,490	无	0	其他
上海灿巢软件咨询中心（有限合伙）	0	3,150,000	2.63	3,150,000	无	0	其他
庄志青	0	3,092,850	2.58	3,092,850	无	0	境外自然人
海通创新证券投资有限公司	-760,000	2,885,960	2.40	1,500,000	无	0	国有法人
上海灿成企业管理中心（有限合伙）		2,849,400	2.37	2,849,400	无	0	其他
BRITE EAGLE HOLDINGS, LLC	-2,862,836	2,026,234	1.69	0	无	0	境外法人
中信银行股份有限公司－中欧信息科技混合型发起式证券投资基金	1,759,077	1,759,077	1.47	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	庄志青、上海维灿企业管理中心（有限合伙）、上海灿巢软件咨询中心（有限合伙）、上海灿成企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，公司共实现营业收入72,444.62万元，同比减少33.52%，实现归属于上市公司股东的净利润为-11,032.08万元，同比减少280.71%。具体经营情况分析详见本节“二、经营情况讨论与分析” 相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688691　　证券简称：灿芯股份　　公告编号：2026-018

灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理产品种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。
- 现金管理金额：灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过人民币35,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
- 履行的审议程序：公司于2026年4月16日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东会审议。
- 现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月。
- 风险提示：虽然公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品，但受金融市场宏观政策影响，不排除本次购买的产品可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，导致产品收益波动。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理金额

公司拟使用总额不超过人民币35,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营。

（四）实施方式

为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等产品）。董事会授权总经理在前述额度及授权期限内负责实施及签署相关协议。

（五）授权期限

本次现金管理授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

2026年4月16日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币35,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权总经理负责实施及签署相关协议。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月。本事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

虽然公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品，但受金融市场宏观政策影响，不排除本次购买的产品可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，导致产品收益波动。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

2、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常经营的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，对公司未来的财务状况和现金流量不会造成重大影响，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：688691　　证券简称：灿芯股份　　公告编号：2026-015

灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于聘任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元， 其中审计业务收入234,862.94万元， 证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：何双，2014年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署、复核过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张梦妮，2021年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署、复核过2家上市公司审计报告。

项目质量复核人：梁宝珠，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署、复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

（1）定价原则

根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

（2）费用情况

2026年度审计费用总计为140万元（不包含差旅费），其中财务报告审计费用为120万元，内部控制审计费用为20万元，与2025年度审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

2026年4月15日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于聘任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员会在选聘公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构过程中，对容诚会计师事务所进行了审查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计的工作要求。董事会审计委员会同意聘任容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月16日，公司第二届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：688691　　证券简称：灿芯股份　　公告编号：2026-013

灿芯半导体（上海）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月16日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议通知于2026年4月3日以邮件通知方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。本次会议由董事长庄志青先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事庄志青回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案中高级管理人员的薪酬方案尚需提交2025年年度股东会听取。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

（八）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会听取。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事（王泽霞）述职报告》《2025年度独立董事（王志华）述职报告》《2025年度独立董事（邵春阳）述职报告》《2025年度独立董事（张鹏岗）述职报告》。

（十）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事王志华、独立董事王泽霞、独立董事邵春阳、独立董事张鹏岗回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于〈审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十二）审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

（十三）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-014）。

（十四）审议通过《关于公司〈2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（十五）审议通过《关于聘任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

（十六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

（十七）审议通过《关于2025年日常关联交易执行情况及预计2026年日常关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王永、郭文涛、熊伟回避表决。

本议案已经第二届董事会独立董事第二次专门会议以全票同意审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年日常关联交易执行情况及预计2026年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

（十八）审议通过《关于公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十九）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意择日召开公司2025年年度股东会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：688691　　证券简称：灿芯股份

灿芯半导体（上海）股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688691
公司简称	灿芯股份
公司名称	灿芯半导体（上海）股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	1、联合国2030年可持续发展目标（SDGs） 2、全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 3、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》 4、中国社科院《中国企业社会责任报告指南》（CASS-ESG 5.0） 5、中国标准化研究院《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015） 6、国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会战略委员会__□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_董事会战略委员会对公司可持续发展和ESG相关政策进行研究并提出建议，战略委员会的提案提交董事会审议决定___□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__《灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会战略委员会工作细则》___□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东与投资者	信息披露 中小股东权益保护 投资者关系	股东会 业绩交流会 接待投资者现场调研 回复投资者电话、邮件、网络留言 各类信息披露平台
政府与监管机构	依法纳税 合规经营 反腐败 促进经济发展 带动就业	证券交易所会议 政府会议 政府参观调研 各类信息披露平台
员工	薪酬福利 健康安全 职业发展 民主沟通	职工代表大会 员工满意度调查 绩效面谈 公司内部通讯网络
客户	产品质量 售后服务	客户即时沟通 客户现场拜访 客户服务热线 各类行业论坛、交流会议
供应商与行业	公平公开采购 遵守商业道德 推动行业发展 公平竞争	现场拜访 来访接待 各类行业论坛、交流会议 电话、邮件等各类通讯工具
社会公众	污染防治 节能减排 公益慈善	各类信息披露平台 公司官方网站、公众号等

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	气候风险与应对	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	创新为擎	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
3	构建绿色供应链	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
4	坚守质量底线	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
5	信息数据安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
6	员工雇佣与发展；员工关怀	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
7	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的有污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、平等对待中小企业、反不正当竞争、尽职调查、利益相关方沟通）均在报告附录：指标索引中进行解释说明，尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。

证券代码：688691　　证券简称：灿芯股份　　公告编号：2026-014

灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本；
- 本次拟不进行利润分配的方案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议；
- 公司2025年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润为人民币-110,320,847.20元。

公司于2026年4月16日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次拟不进行利润分配的方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第七条的规定，上市公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红方案。《公司章程》第一百六十条第四项明确了公司实施现金分红的条件：“1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，结合相关法律法规，综合考虑公司目前经营计划和实际经营需求等因素，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

2026年4月16日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并将其提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：688691　　证券简称：灿芯股份　　公告编号：2026-016

灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于2025年日常关联交易执行情况及预计2026年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是出于灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“灿芯股份”）正常经营活动所需，公司与关联人之间的交易是基于日常业务过程中的一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公平、公正原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司不会因该关联交易对关联人形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月16日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及预计2026年日常关联交易的议案》，对公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易事项进行了确认，公司关联董事郭文涛、王永、熊伟回避表决。

公司于2026年4月16日召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，以全票同意审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及预计2026年日常关联交易的议案》，独立董事专门会议认为：相关关联交易事项是为了满足公司生产经营的需要，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规以及公司相关制度的规定。因此全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）2025年度日常关联交易的执行情况（单位：万元）

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及服务	中芯国际集成电路制造有限公司及其子公司	60,000.00	35,525.16	系市场行情不及预期导致
向关联人销售商品、提供服务	深圳市楠菲微电子有限公司及其子公司	800.00	784.40	/
总计		60,800.00	36,309.56	/

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及服务	中芯国际集成电路制造有限公司及其子公司	50,000.00	90	35,525.16	75	根据实际业务情况预计
总计		50,000.00	/	/	/	/

注：占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/该年度同类业务的预计发生额或实际发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、中芯国际集成电路制造有限公司及其子公司

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”）是一家于2000年4月3日在开曼群岛注册成立的有限公司，注册地址为Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681,Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands，公司办公地址为中国上海市浦东新区张江路18号，负责人为刘训峰。中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务。中芯国际无控股股东和实际控制人。截至2025年12月31日，中芯国际第一大股东为大唐控股（香港）投资有限公司。

截至2025年12月31日，中芯国际总资产为367,718,196千元，净资产为150,823,788千元，2025年度实现营业收入67,323,192千元，实现归属于上市公司股东的净利润5,040,734千元。

（二）与上市公司的关联关系

公司持股5%以上的股东中芯国际控股有限公司是中芯国际的全资子公司。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。公司及子公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司根据实际经营需要向中芯国际及其子公司采购晶圆、光罩。

（二）定价政策及定价依据

公司与关联方之间已经保持稳定的商业关系，公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据，定价具有公允性。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算。

（三）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的合同或协议。已签订且仍有效的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，结算时间和方式合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

关联交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联人形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司上述2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，关联董事予以回避表决。上述事项尚需提交股东会审议。公司上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。公司上述关联交易均为开展日常经营活动所需，未损害公司或股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对灿芯股份2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：688691　　证券简称：灿芯股份　　公告编号：2026-017

灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于2024年1月17日出具的《关于同意灿芯半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]106号）批准同意，公司首次公开发行人民币普通股3,000.00万股，本次发行募集资金总额59,580.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为52,129.49万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2024年4月8日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0016号），验证募集资金已全部到位。上述募集资金已经全部存放于经董事会批准的募集资金专户管理，公司及公司子公司灿芯半导体（苏州）有限公司（以下简称“灿芯苏州”）已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）2025年年度募集资金使用情况及结余情况

2025年度，本公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024年4月8日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	59,580.00
减：发行费用合计	7,450.51
二、募集资金净额	52,129.49
减：	
以前年度已使用金额	7,315.23
本年度使用金额	11,504.35
现金管理金额	16,500.00
加：	
募集资金利息收入（扣除手续费净额）和投资收益金额	847.90
三、报告期期末募集资金余额	17,657.80

注：本报告个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成，下同

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者利益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《灿芯半导体（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。

本公司及灿芯苏州已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，截至2025年12月31日，监管协议履行正常。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称			2024年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2024年4月8日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
灿芯半导体（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121907617210001	7,777.51	使用中
灿芯半导体（上海）股份有限公司	浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	2900000210120100179928	4,467.80	使用中
灿芯半导体（上海）股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301230000009378	5,007.81	使用中
灿芯半导体（苏州）有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州湖东新街口支行	32250198814609888888	404.67	使用中
合计			17,657.80	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币18,819.59万元（其中本报告期内投入11,504.35万元），具体使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年8月28日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金人民币3,172.42万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币448.85万元置换已支付发行费用。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于灿芯半导体（上海）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》， 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具了容诚专字[2024]200Z0340号《关于灿芯半导体（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。上述置换事项已于2024年9月实施完毕。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2024年4月8日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
网络通信与计算芯片定制化解决方案平台	29,929.32	2,466.10	2,466.10	2024年9月	2024年8月28日
工业互联网与智慧城市的定制化芯片平台	20,540.57	291.20	291.20	2024年9月	2024年8月28日
高性能模拟IP建设平台	9,534.86	415.12	415.12	2024年9月	2024年8月28日

2024年8月28日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》。同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月28日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于灿芯半导体（上海）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2025年8月27日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目使用进度安排的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的商业银行保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构出具了《国泰海通证券股份有限公司关于灿芯半导体（上海）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称		2024年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2024年4月8日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
20,000.00	购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品	2024年8月28日	2025年8月27日	2024年8月28日
20,000.00	购买安全性高、流动性好的商业银行保本型投资产品	2025年8月27日	2026年8月26日	2025年8月27日

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称			2024年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2024年4月8日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	浙商银行	大额存单	大额存单	10,000.00	2024-9-24	2025-3-24	2025-3-24	/	1.80%	90.00
公司	浙商银行	大额存单	大额存单	10,000.00	2025-3-25	2025-6-25	2025-6-25	/	1.35%	33.75
公司	浙商银行	大额存单	大额存单	10,000.00	2025-10-24	2026-4-24	/	10,000.00	1.20%	/
公司	招商银行	大额定期存款	大额定期存款	6,000.00	2024-9-6	2025-3-6	2025-3-6	/	1.75%	52.50
公司	招商银行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025-1-10	2025-4-10	2025-4-10	/	2.00%	14.79
公司	招商银行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025-3-19	2025-6-19	2025-6-19	/	2.00%	30.25
公司	招商银行	结构性存款	结构性存款	3,500.00	2025-4-16	2025-7-16	2025-7-16	/	2.00%	17.45
公司	招商银行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025-6-23	2025-7-24	2025-7-24	/	1.85%	9.43
公司	招商银行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025-9-2	2025-9-30	2025-9-30	/	1.64%	7.55
公司	招商银行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025-9-4	2025-12-3	2025-12-3	/	1.70%	20.96
公司	招商银行	结构性存款	结构性存款	2,500.00	2025-10-20	2026-1-16	/	2,500.00	1.00%或1.70%	/
公司	招商银行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025-11-7	2026-2-4	/	2,000.00	1.00%或1.70%	/
公司	招商银行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025-12-9	2026-2-9	/	2,000.00	1.00%或1.65%	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：灿芯股份2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了灿芯股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《灿芯半导体（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
2026年4月17日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2024年4月8日												
本年度投入募集资金总额	11,504.35												
已累计投入募集资金总额	18,819.59												
变更用途的募集资金总额	-												
变更用途的募集资金总额比例	0.00%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
网络通信与计算芯片定制化解决方案平台	研发项目	否	29,929.32	26,002.19	26,002.19	6,910.62	11,918.16	-14,084.03	45.84	2027年4月	不适用	不适用	否
工业互联网与智慧城市的定制化芯片平台	研发项目	否	20,540.57	17,843.92	17,843.92	2,187.73	3,496.75	-14,347.17	19.60	2027年4月	不适用	不适用	否
高性能模拟IP建设平台	研发项目	否	9,534.86	8,283.38	8,283.38	2,406.01	3,404.69	-4,878.69	41.10	2027年4月	不适用	不适用	否
合计			60,004.75	52,129.49	52,129.49	11,504.35	18,819.59	-33,309.90	36.10	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见·三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：本公司于2024年5月31日召开公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。